

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月5日(05.06.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/115824 A1

(51) 国際特許分類:

C08F 8/40 (2006.01) C08K 5/14 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) C08L 9/00 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) C09J 7/35 (2018.01)
C08C 19/24 (2006.01) C09J 109/00 (2006.01)
C08F 36/06 (2006.01) H01B 3/28 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) H05K 1/03 (2006.01)

井南海岸 1 2 - 5 4 日本曹達株式会社内 (JP).
斎藤 瑞樹(SAITO, Mizuki); 〒2900045 千葉県
市原市五井南海岸 1 2 - 5 4 日本曹達株式
会社内 (JP). 柴田 靖久(SHIBATA, Yasuhisa);
〒2900045 千葉県市原市五井南海岸 1 2 -
5 4 日本曹達株式会社内 (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/041703

(22) 国際出願日: 2024年11月26日(26.11.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-203637 2023年12月1日(01.12.2023) JP
特願 2024-035351 2024年3月7日(07.03.2024) JP

(71) 出願人: 日本曹達株式会社(NIPPON SODA CO.,
LTD.) [JP/JP]; 〒1007010 東京都千代田区丸
の内二丁目7番2号 (JP).

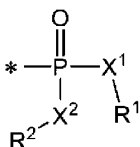
(72) 発明者: 河西 拓也(KAWANISHI, Takuya);
〒2900045 千葉県市原市五井南海岸 1 2 -
5 4 日本曹達株式会社内 (JP). 山手 太軌
(YAMATE, Taiki); 〒2900045 千葉県市原市五

(74) 代理人: 廣田 雅紀(HIROTA, Masanori);
〒1070052 東京都港区赤坂二丁目2番1
9号アドレスビル6階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,
EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: COMPOSITION FOR INSULATING LAYER OF PRINTED WIRING BOARD

(54) 発明の名称: プリント配線板の絶縁層用組成物



(III)

(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a composition for use in an insulating layer of a printed wiring board, said composition having a low dielectric constant, a low dielectric loss tangent, and flame retardancy. This resin composition for use in an insulating layer of a printed wiring board includes a polybutadiene, wherein the molar ratio of 1,2 bond structures to 1,4 bond structures in the polybutadiene is 60:40 to 100:0, and bonded to at least one carbon atom in the polybutadiene is a phosphorus-including group represented by formula (III) (in formula (III), * represents a bond location, X¹ and X² each independently represent a single bond or an oxygen atom, and R¹ and R² each independently represent an organic group).

(57) 要約: 本発明の課題は、低誘電率且つ低誘電正接であり、かつ、難燃性を有する、プリント配線板の絶縁層に用いるための組成物を提供することである。ポリブタジエンを含有し、前記ポリブタジエン中の1, 2結合構造と1, 4結合構造のモル比が、60:40~100:0であり、前記ポリブタジエン中の一つ以上の炭素原子に、式(III) (式(III)中、*は結合位置を示し、X¹及びX²は、それぞれ独立して、単結合又は酸素原子を示し、R¹及びR²は、それぞれ独立して、有機基を示す。)で表されるリン含有基が結合している、プリント配線板の絶縁層に用いるための樹脂組成物。

[続葉有]

WO 2025/115824 A1

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))